First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection : Rrint

L12: Entry 1 of 2

File: JPAB

Nov 2, 2001

PUB-NO: JP02001308741A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001308741 A

TITLE: TRANSPONDER AND PRODUCTION METHOD OF THE SAME

PUBN-DATE: November 2, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIMURA, KAZUHIRO ISHIKAWA, KAZUNORI MARUYAMA, HIROISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

YOKOHAMA RUBBER CO LTD: THE

APPL-NO: JP2000120893 APPL-DATE: April 21, 2000

INT-CL (IPC): $\underline{\text{HO4}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{1/59}$; $\underline{\text{HO4}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{1/38}$; $\underline{\text{HO1}}$ $\underline{\text{L}}$ $\underline{21/56}$; $\underline{\text{HO1}}$ $\underline{\text{L}}$ $\underline{23/28}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transponder which is excellent in heat resistance and impact resistance, and has large degree of freedom of shape, and production method of the same.

SOLUTION: This transponder is formed by coating a transponder parts with silicon resin or crosslinkabe polyethylene resin. Besides, in the production method, the silicon resin is cured after inserting the responder parts and the non-cured silicon resin between both of silicon resin sheets, or the non-cured crosslinkable polyethylene resin is cured after inserting the transponder parts between both of non-cured crosslinkable polyethylene resin sheets.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection Print

L8: Entry 2 of 2

File: DWPI

Nov 2, 2001

DERWENT-ACC-NO: 2002-059747

DERWENT-WEEK: 200208

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Tire embedded transponder for transmitting various information, has transponder element coated with silicone resin or crosslinked polyethylene resin

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

YOKOHAMA RUBBER CO LTD

YOKO

PRIORITY-DATA: 2000JP-0120893 (April 21, 2000)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

☐ JP 2001308741 A

November 2, 2001

006

H04B001/59

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP2001308741A

April 21, 2000

2000JP-0120893

INT-CL (IPC): $\underline{\text{H01}}$ $\underline{\text{L}}$ $\underline{21/56}$; $\underline{\text{H01}}$ $\underline{\text{L}}$ $\underline{23/28}$; $\underline{\text{H04}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{1/38}$; $\underline{\text{H04}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{1/59}$

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001308741A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Transponder element placed on silicone resin sheet (4), is coated with silicone resin or crosslinked polyethylene resin.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for transponder manufacturing method.

USE - Is embedded in tire for transmitting various information.

ADVANTAGE - Has good heat resistance and impact strength. Minimizes stress from tire structure on built-in circuitry.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a longitudinal sectional view of the transponder.

Silicone resin sheet 4

Record Display Form Page 2 of 2

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/12

TITLE-TERMS: EMBED TRANSPONDER TRANSMIT VARIOUS INFORMATION TRANSPONDER ELEMENT

COATING SILICONE RESIN CROSSLINK POLYETHYLENE RESIN

DERWENT-CLASS: U11 W02

EPI-CODES: U11-E02A1; W02-G02; W02-G05;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2002-044356

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-308741 (P2001-308741A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

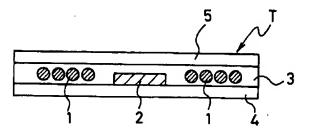
(E1) I_A C1 7	200121 FL	FI	= == 1*/sb=k)	
(51) Int.Cl. ⁷	酸別記号		デーマコート*(参考)	
H04B 1/59		H04B 1/5		
1/38		1/3	\$ 5F061	
# H O 1 L 21/56		H01L 21/5	56 R 5K011	
23/28		23/28 E		
		審査請求未	未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)	
(21)出願番号	特願2000-120893(P2000-120893)	(71)出願人 00	000006714	
		梭	段兵ゴム株式会社	
(22)出顧日	平成12年4月21日(2000.4.21)	<u> </u>	東京都港区新橋5丁目36番11号	
		(72)発明者 志	村 一浩	
		#	神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株	
			(会社平塚製造所内	
		(72)発明者 石	5川 和憲	
			神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株	
	•		《 会社平塚製造所内	
			00066865	
			P理士 小川 信一 (外2名)	
		"	141 UV	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 トランスポンダおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 耐熱性、耐衝撃性に優れかつ形状の自由度の 大きいトランスポンダおよびその製造方法の提供。

【解決手段】 このトランスポンダは、シリコン樹脂又は架橋性ポリエチレン樹脂でトランスポンダ部品を被覆してなる。また、その製造方法は、トランスポンダ部品および未硬化のシリコン樹脂を両方のシリコン樹脂のシートで挟み込んだ後にシリコン樹脂を硬化させること、又はトランスポンダ部品を両方の未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシートで挟み込んだ後、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂を硬化させることからなる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコン樹脂又は架橋性ポリエチレン樹脂でトランスポンダ部品を被覆してなるトランスポンダ・

【請求項2】 シリコン樹脂のシートの上にトランスポンダ部品を配置し、ついでこのトランスポンダ部品を未硬化のシリコン樹脂で被覆し、その上にシリコン樹脂の別のシートを配置して、トランスポンダ部品および未硬化のシリコン樹脂を両方のシートで挟み込んだ後、シリコン樹脂を硬化させてなるトランスポンダの製造方法。 【請求項3】 未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシートの上にトランスポンダ部品を配置し、ついでその上に未硬化架橋性ポリエチレン樹脂の別のシートを配置して、トランスポンダ部品を両方のシートで挟み込んだ後、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂を硬化させてなるトランスポンダの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、キー(鍵)に内蔵させたり、タイヤ内に埋設させたりして種々の情報を発 20 信させるなどに用いるトランスポンダおよびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、トランスポンダは、アンテナコイル、電子回路等のトランスポンダ部品をガラス管又はエポキシ樹脂硬質管に内蔵させてなる。

【0003】しかしながら、ガラス管を用いたトランスポンダは、衝撃に弱く、タイヤ内に埋設させた場合には走行中に割れる恐れがある。そこで、この対策として例えば特開平7-223413号公報に示されるようにガ 30 ラス管の外表面をゴムと共加硫性を有する樹脂で被覆してタイヤ内に埋設させるようにしているが、このようにトランスポンダを樹脂の2次パッケージに納めるという手法によると、2次パッケージ用のモールドが必要であり、また作業工数も増えるため高価になってしまう。さらに、ガラス管に内蔵させるアンテナの大きさにも制限がある。

【0004】一方、エポキシ樹脂硬質管の場合にはガラス管に比して衝撃には強いが、成形用のモールドが必要であり、また、大きなアンテナのトランスポンダでは強 40度を保持するために厚みが増えてしまうという問題がある。

【0005】このように、ガラス管又はエポキシ樹脂硬質管を用いるトランスポンダは、必ずモールドが必要であるため大きさ・形状に制限があり、高価となるという問題がある。

[0006]

* 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、耐熱性、耐衝撃性に優れかつ形状の自由度の大きいトランスポンダおよびその製造方法を提供することにある。 【0007】

【課題を解決するための手段】本発明のトランスポンダは、シリコン樹脂又は架橋性ポリエチレン樹脂でトランスポンダ部品を被覆してなることを特徴とする。

【0008】また、本発明のトランスポンダの製造方法は、シリコン樹脂のシートの上にトランスポンダ部品を配置し、ついでこのトランスポンダ部品を未硬化のシリコン樹脂で被覆し、その上にシリコン樹脂の別のシートを配置して、トランスポンダ部品および未硬化のシリコン樹脂を両方のシートで挟み込んだ後、シリコン樹脂を硬化させてなることを特徴とする。

【0009】さらに、本発明のトランスポンダの別の製造方法は、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシートの上にトランスポンダ部品を配置し、ついでその上に未硬化架橋性ポリエチレン樹脂の別のシートを配置して、トランスポンダ部品を両方のシートで挟み込んだ後、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂を硬化させてなることを特徴とする。

【0010】このように、耐熱性、耐衝撃性に優れたシリコン樹脂又は架橋性ポリエチレン樹脂でトランスポンダ部品を被覆するために、耐熱性、耐衝撃性に優れたトランスポンダを得ることが可能となる。また、トランスポンダ部品および未硬化のシリコン樹脂を両方のシリコン樹脂のシートで挟み込んだ後にシリコン樹脂を硬化させること、又はトランスポンダ部品を両方の未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシートで挟み込んだ後、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂を硬化させること、というモールドを使用することのない方法でトランスポンダを製造するために、トランスポンダの形状の自由度を大きくすることができる。

[0011]

【発明の実施の形態】図1に本発明のトランスポンダの一例の縦断面を示す。図1において、アンテナコイル1 および電子回路2からなるトランスポンダ部品を埋設したシリコン樹脂層3の上下両面にシリコン樹脂のシート4、5を配置することによりトランスポンダ下が形成される。すなわち、トランスポンダTは、シリコン樹脂でトランスポンダ部品を被覆してなる。

【0012】シリコン樹脂としては、特に限定されるものではないが、常温付近で弾性を示すエラストマーであるのがよい。好適なシリコン樹脂は、例えば、下記の物性を有するダウ・コーニング社製のシラスコンRTV7500である。

0.061

硬化後(25℃、常温3日)物性

硬度(JIS A) 引張強度(kgf/cm²)

55 54

. .

12 引裂強度(kgf/cm) 伸び(%) 300 比重 1.30 使用温度範囲(℃) $-55\sim200$ 25-1440. 硬化時間(温度℃-分) 60 - 120100 - 30120 - 20

このトランスポンダTの製造方法について下記のΦに述 10*矢印で示すように必要に応じて両側から加圧しながら常 べる。

【0013】 ② まず、図2に示すように、マイラーシ ート(離型シート)10の上にシリコン樹脂のシート1 1をのせる。シート11を構成するシリコン樹脂は、硬 化していても未硬化であってもいずれでもよい。シリコ ン樹脂が未硬化で液状物の場合には、その液状物をマイ ラーシート10の上にシート状に塗布してシート11を 形成すればよい。

【0014】ついで、シート11の上に、図3に示すよ うに、アンテナコイル1および電子回路2からなるトラ 20 ンスポンダ部品を配置する。アンテナコイル1は、ワイ ヤを数回から数百回巻くことによりコイル状に形成させ たものである。つぎに、図4に示すように、このトラン スポンダ部品を未硬化のシリコン樹脂で被覆する。被覆 に際しては、この未硬化のシリコン樹脂が液状物の場合 には、その液状物をトランスポンダ部品に塗布して、ト ランスポンダ部品をその液状物に埋設させるとよい。こ れにより被覆物12を形成する。

【0015】被覆物12の上には、図5に示すように、 シリコン樹脂の別のシート13を配置して、アンテナコ 30 イル1および電子回路2からなるトランスポンダ部品と 未硬化のシリコン樹脂の被覆物12とを両方のシート1 1および13で挟み込む。シート13を構成するシリコ ン樹脂もまた、硬化していても未硬化であってもいずれ でもよい。つぎに、この挟み込んだものを図5において*

法によりシリコン樹脂を硬化させる。

150-10

【0016】硬化後には、図6に示すような一体化物2 0が得られる。この一体化物20を任意の形状に切り出 し、又は打ち抜き、それからマイラーシート10を剥が すと図7に示すようなトランスポンダTとなる。マイラ ーシート10は、切り出し、打ち抜き作業を行う前に剥 がしてもよい。なお、トランスポンダTの上下両面のい ずれかで厚さを変えたい場合には、シート11又は別の シート13のいずれかを複数枚配置するか、或いはこれ らのシートの厚さを適宜加減したりすればよい。

【0017】図8に本発明のトランスポンダの他例の縦 断面を示す。図8において、アンテナコイル1および電 子回路2からなるトランスポンダ部品を架橋性ポリエチ レン樹脂30に埋設することによりトランスポンダMが 形成される。すなわち、トランスポンダMは、架橋性ポ リエチレン樹脂でトランスポンダ部品を被覆してなる。 【0018】架橋性ポリエチレン樹脂は、ポリエチレン にジクミルパーオキサイド等の有機過酸化物を加えたも ので、加熱によりポリエチレン分子間を架橋させること ができる。この架橋性ポリエチレン樹脂もまた、特に限 定されるものではないが、常温付近で可塑性を示すプラ ストマーであるのがよい。好適な架橋性ポリエチレン樹 脂としては、例えば、下記の物性を有する日本ユニカー 社製の架橋型ポリエチレン(型番: HFDJ-420 1)を挙げることができる。

硬化後の機械的性質

引張強さ(MPa) 27 引裂破壊伸び(%) 560 比重 0.922脆化温度(℃) -76加工温度(℃) $125 \sim 130$ (120℃-15分)

このトランスポンダMの製造方法について下記の②で述 べる。

【0019】 ② まず、 図9に示すように、マイラーシ ート(離型シート)10の上に未硬化架橋性ポリエチレ ン樹脂のシート31をのせる。つぎに、この未硬化架橋 性ポリエチレン樹脂のシート31の上に、図10に示す ように、アンテナコイル1および電子回路2からなるト ランスポンダ部品を配置する。 **※50**

※【0020】ついで、図11に示すように、トランスポ ンダ部品の上に、別の未硬化架橋性ポリエチレン樹脂の シート32を配置して、トランスポンダ部品を両方の未 硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシート31、32で挟み 込む。ついで、未硬化架橋性ポリエチレン樹脂を常法に より硬化させる。例えば、0.3MPaの圧力下に18 0℃で15分加熱を行うことにより硬化させればよい。 【0021】硬化後には、図12に示すような一体化物

40が得られる。この一体化物40を任意の形状に切り 出し、又は打ち抜き、それからマイラーシート10を剥 がすとトランスポンダMとなる。マイラーシート10 は、切り出し、打ち抜き作業を行う前に剥がしてもよ 11

【0022】本発明においてシリコン樹脂からなるトラ ンスポンダTは、シリコン樹脂が他の物質と接着し難い ため、タイヤ内に埋設して用いるのに便利である。タイ ヤ内に埋設した場合、トランスポンダが周辺ゴムと接着 しないので、走行中のタイヤの変形による応力がトラン 10 である。 スポンダ内蔵回路に伝えられるのが緩和されると共に、 タイヤ走行中に繰り返されるせん断力・曲げ力について の伝達も緩和されるからである。

【0023】一方、本発明において架橋性ポリエチレン 樹脂からなるトランスポンダMは、架橋性ポリエチレン 樹脂がシリコン樹脂とは異なって接着性に優れているた め、タイヤに用いる場合にはタイヤ内外面の適当箇所 (例えば、走行中に殆ど動きのないタイヤ内面のビード 部近傍)に貼り付けるようにするとよい。

【0024】これらのトランスポンダT又はMは、例え 20 ば、受動トランスポンダである。

[0025]

•

【発明の効果】以上説明したように本発明のトランスポ ンダは、シリコン樹脂又は架橋性ポリエチレン樹脂でト ランスポンダ部品を被覆してなるために、耐熱性、耐衝 撃性を向上させることができるうえに、下記の効果を奏 することが可能となる。

【0026】(1) シリコン樹脂からなるトランスポンダ の場合、タイヤに埋め込んで使用すると他の部材と接着 されないため、トランスポンダ内蔵回路に及ぼすタイヤ 30 構造からの応力を緩和できる。

【0027】(2) 架橋性ポリエチレン樹脂からなるトラ ンスポンダの場合、タイヤ外面の適当箇所に貼り付けて 使用するに際して、タイヤ加硫前にタイヤモールド内に トランスポンダを設置しておくことにより加硫後にタイ ヤ外面への接着が可能となる。

【0028】また、本発明のトランスポンダの製造方法 によれば、モールドを使用することがないので、トラン スポンダの形状の自由度を大きくすることができるうえ に、下記の効果を奏することが可能となる。

【0029】 ② 薄くても耐熱性のよいトランスポンダ を製作することが可能となる。

【0030】② 柔軟なトランスポンダとなり、取付け 対象物の形状に合わせて使用が可能となる。

【0031】③ トランスポンダ内蔵回路からの被覆物 の厚さ(被覆物表面までの距離)を表裏(上方下方)で 任意に変更することができるので、薄いトランスポンダ から厚いトランスポンダまで適宜任意に製作することが 可能となる。

め、トランスポンダを安価に製作することができ、ま た、多品種生産にも対応が可能となる。

【0033】 ⑤ 通信アンテナ (アンテナコイル)が大 きい場合でも、耐熱性、耐衝撃性に優れた薄いトランス ポンダを製作することが可能となる。

【0034】⑥ 寸法安定性に優れたトランスポンダを 製作することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のトランスポンダの一例の縦断面説明図

【図2】マイラーシートの上でシリコン樹脂又は架橋性 ポリエチレン樹脂のシートを形成する工程を示す説明図 である。

【図3】図2の工程で形成されたシートの上にトランス ポンダ部品を配置する工程を示す説明図である。

【図4】図3の工程で配置されたトランスポンダ部品を 未硬化のシリコン樹脂で被覆する工程を示す説明図であ る。

【図5】図4の工程で被覆された被覆物の上に別のシー トを配置した後に硬化を行う工程を示す説明図である。 【図6】図5の工程で得られる一体化物を示す説明図で ある。

【図7】図6で示される一体化物を任意の形状に切り出 し又は打ち抜くことによって得られるトランスポンダの 一例を示す説明図である。

【図8】本発明のトランスポンダの他例の縦断面説明図 である。

【図9】マイラーシートの上に未硬化架橋性ポリエチレ ン樹脂のシートを配置する工程を示す説明図である。

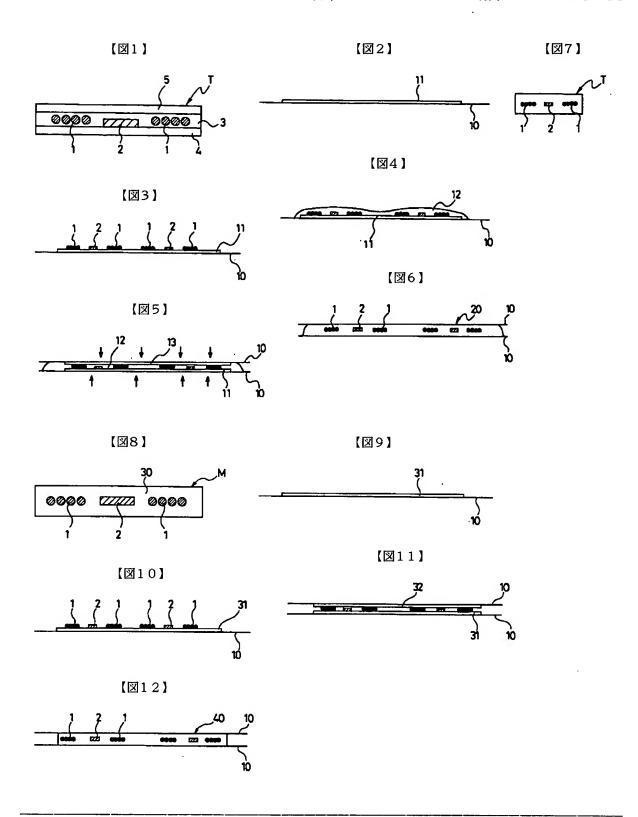
【図10】図9の工程で配置された未硬化架橋性ポリエ チレン樹脂のシートの上にトランスポンダ部品を配置す る工程を示す説明図である。

【図11】図10の工程で配置されたトランスポンダ部 品の上に別の未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシートを 配置する工程を示す説明図である。

【図12】図11の工程で得られる一体化物を示す説明 図である。

【符号の説明】

- 1 アンテナコイル
- 2 電子回路 40
 - 3 シリコン樹脂の層
 - 4、5 シリコン樹脂のシート
 - 10 マイラーシート
 - 11 シリコン樹脂のシート
 - 12 被覆物
 - 13 別のシリコン樹脂のシート
 - 20 一体化物
 - 31 未硬化架橋性ポリエチレン樹脂のシート
 - 32 未硬化架橋性ポリエチレン樹脂の別のシート



フロントページの続き

(72)発明者 丸山 博功

神奈川県平塚市追分2番1号 横浜ゴム株式会社平塚製造所内

F ターム(参考) 4M109 AA01 BA07 CA04 CA26 EA01 EA10 EC03 EC05 GA02 GA10 5F061 AA01 CA04 CA26 FA02 FA06 5K011 AA00 AA01 AA12 JA00 KA00 KA13 LA07

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention is made to build in a key (key), or is made to lay underground in a tire and relates to the transponder used for making it disseminate various information etc., and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] A transponder makes it come conventionally to build transponder components, such as antenna coil and an electronic circuitry, in a glass tube or epoxy resin hard tubing. [0003] However, the transponder using a glass tube is weak against an impact, and when it is made to lay underground in a tire, it has a possibility that it may be divided during transit. Then, according to the technique of dedicating a transponder to the secondary package of resin in this way, although the outside surface of a glass tube is covered with the resin which has rubber and covulcanization nature and he is trying to make it lay underground in a tire as shown in JP,7-223413,A as this cure, the mold for a secondary package is required, and since an activity man day also increases, it will become expensive. Furthermore, the magnitude of the antenna made to build in a glass tube also has a limit.

[0004] On the other hand, in the case of epoxy resin hard tubing, although it is strong against an impact, in order to hold reinforcement by the transponder of an antenna with the mold big required for shaping as compared with a glass tube, there is a problem that thickness will increase.

[0005] Thus, since mold is surely required, the transponder using a glass tube or epoxy resin hard tubing has a limit in magnitude and a configuration, and it has the problem of becoming expensive. [0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The purpose of this invention is to excel in thermal resistance and shock resistance, and offer the large transponder and its manufacture approach of a degree of freedom of a configuration.

[0007]

[Means for Solving the Problem] The transponder of this invention is characterized by coming to cover transponder components with silicon resin or cross-linking polyethylene resin.

[0008] Moreover, after the <u>manufacture approach</u> of the transponder of this invention <u>arranges</u> transponder components on the sheet of silicon resin, subsequently covers them with the silicon resin this transponder component of whose is not hardened, <u>arranges another sheet of silicon resin on it and puts transponder components and non-hardened silicon resin with both sheets, it is characterized by making it come to harden silicon resin.</u>

[0009] Furthermore, after the another manufacture approach of the transponder of this invention arranges transponder components, subsequently to a it top, arranges another sheet of non-hardened cross-linking polyethylene resin and puts transponder components with both sheets on the sheet of non-hardened cross-linking polyethylene resin, it is characterized by making it come to harden non-hardened cross-linking polyethylene resin.

[0010] Thus, in order to cover transponder components with silicon resin or cross-linking polyethylene

resin excellent in thermal resistance and shock resistance, it becomes possible to obtain the transponder excellent in thermal resistance and shock resistance. Moreover, after putting stiffening silicon resin after putting transponder components and non-hardened silicon resin with the sheet of both silicon resin, or transponder components with the sheet of both non-hardened cross-linking polyethylene resin, in order to manufacture a transponder by the approach to twist using the mold of stiffening non-hardened cross-linking polyethylene resin, the degree of freedom of the configuration of a transponder can be enlarged. [0011]

[Embodiment of the Invention] The longitudinal section of an example of the transponder of this invention is shown in <u>drawing 1</u>. In <u>drawing 1</u>, Transponder T is formed in vertical both sides of the silicon resin layer 3 under which the transponder components which consist of <u>antenna coil 1</u> and an electronic circuitry 2 were laid by arranging the sheets <u>(4) and (5) of silicon resin</u>. That is, Transponder T comes to cover transponder components with silicon resin.

[0012] Especially as silicon resin, although not limited, it is good that it is the elastomer which shows elasticity near ordinary temperature. Suitable silicon resin is contest RTV 7500 milt by Dow Corning which has the following physical properties.

After hardening (25 degrees C, ordinary temperature three days), physical properties A degree of hardness (JIS A) 55 Tensile strength (kgf/cm2) 54 Tearing strength (kgf/cm) 12 Elongation (%) 300 Specific gravity 1.30 Operating temperature limits (degree C) - 55-200 Setting time (a part for temperature **-) 25-1440 60-120 100-30 120-20 150-10 -- the manufacture approach of this transponder T is stated to following **.

[0013] ** First, as shown in <u>drawing 2</u>, carry the sheet 11 of silicon resin on the Mylar sheet (mold release sheet) 10. The silicon resin which constitutes a sheet 11 may be hardened, or may not be hardened, or any are sufficient as it. By un-hardening, in the case of a liquefied object, silicon resin applies the liquefied object in the shape of a sheet on the Mylar sheet 10, and should just form a sheet 11.

[0014] Subsequently, as shown on a sheet 11 at <u>drawing 3</u>, the transponder components which consist of antenna coil 1 and an electronic circuitry 2 are arranged. Antenna coil 1 makes a wire form in a coiled form by hundreds of times Lycium chinense from several times. Next, as shown in <u>drawing 4</u>, this transponder component is covered with non-hardened silicon resin. It is good to apply that liquefied object to transponder components on the occasion of covering, when the silicon resin which is not hardened [this] is a liquefied object, and to make transponder components lay under that liquefied object. This forms a coating 12.

[0015] On a coating 12, as shown in <u>drawing 5</u>, another sheet 13 of silicon resin is arranged and the transponder components which consist of antenna coil 1 and an electronic circuitry 2, and the coating 12 of non-hardened silicon resin are put with both sheets 11 and 13. The silicon resin which constitutes a sheet 13 may also be hardened, or may not be hardened, or any are sufficient. Silicon resin is stiffened with a conventional method, pressurizing from both sides next, if needed, as an arrow head shows this put thing in <u>drawing 5</u>.

[0016] After hardening, the unification object 20 as shown in drawing 6 is obtained. If this unification object 20 is cut down or pierced in the configuration of arbitration and the Mylar sheet 10 is removed, it will become the transponder T as shown in drawing 7. The Mylar sheet 10 is cut down, and before doing a punching activity, it may be removed. In addition, what is necessary is to arrange either [two or more] a sheet 11 or another sheet 13 or just to adjust the thickness of these sheets suitably to change thickness in either of vertical both sides of Transponder T.

[0017] The longitudinal section of the other examples of the transponder of this invention is shown in drawing 8. In drawing 8, Transponder M is formed by laying under the cross-linking polyethylene resin 30 the transponder components which consist of antenna coil 1 and an electronic circuitry 2. That is, Transponder M comes to cover transponder components with cross-linking polyethylene resin. [0018] Cross-linking polyethylene resin is what added organic peroxide, such as dicumyl peroxide, to polyethylene, and can make between polyethylene molecules construct a bridge with heating. Although this cross-linking polyethylene resin is not limited especially, either, it is good that it is the plastomer

which shows plasticity near ordinary temperature. As suitable cross-linking polyethylene resin, the bridge formation mold polyethylene (part number: HFDJ-4201) by Nippon Unicar which has the following physical properties can be mentioned, for example.

The mechanical property after hardening Tensile strength (MPa) 27 **** destructive elongation (%) 560 Specific gravity 0.922 Brittle temperature (degree C) -76 Working temperature (degree C) 125-130 (120 degree-C-15 minutes)

Following ** describes the manufacture approach of this transponder M.

[0019] ** First, as shown in <u>drawing 9</u>, carry the sheet 31 of non-hardened cross-linking polyethylene resin on the Mylar sheet (mold release sheet) 10. Next, as shown on the sheet 31 of this non-hardened cross-linking polyethylene resin at <u>drawing 10</u>, the transponder components which consist of antenna coil 1 and an electronic circuitry 2 are arranged.

[0020] Subsequently, as shown in <u>drawing 11</u>, on transponder components, the sheet 32 of another non-hardened cross-linking polyethylene resin is arranged, and transponder components are put with the sheets 31 and 32 of both non-hardened cross-linking polyethylene resin. Subsequently, non-hardened cross-linking polyethylene resin is stiffened with a conventional method. For example, what is necessary is just to make it harden by performing heating at 180 degrees C to the bottom of the pressure of 0.3MPa for 15 minutes.

[0021] After hardening, the unification object 40 as shown in <u>drawing 12</u> is obtained. It will become Transponder M, if this unification object 40 is cut down or pierced in the configuration of arbitration and the Mylar sheet 10 is removed. The Mylar sheet 10 is cut down, and before doing a punching activity, it may be removed.

[0022] Since it is hard to paste up silicon resin with other matter, the transponder T which consists of silicon resin in this invention is convenient to lay underground and use into a tire. While it is eased that the stress by deformation of the tire under transit is told to a circuit with a built-in transponder since a transponder does not paste up with circumference rubber when it lays underground in a tire, it is because the transfer about the shearing force and the bending force repeated during tire transit is also eased. [0023] Since cross-linking polyethylene resin is excellent in the adhesive property unlike silicon resin, the transponder M which consists of cross-linking polyethylene resin in this invention on the other hand is good to make it stick on the suitable part (the toe of bead of a tire inside without the almost motion during transit near [for example,]) of a tire inside-and-outside side, when using for a tire.

[0024] These transponders T and M are for example, passive transponders.

[0025]

[Effect of the Invention] As explained above, since transponder components are covered with silicon resin or cross-linking polyethylene resin and it becomes with it, the transponder of this invention becomes possible [being able to raise thermal resistance and shock resistance, and also doing the following effectiveness so].

[0026] (1) Since in the case of the transponder which consists of silicon resin it will not paste up with other members if it is used embedding into a tire, the stress from the tire structure exerted on a circuit with a built-in transponder can be eased.

[0027] (2) In the case of the transponder which consists of cross-linking polyethylene resin, it faces using it for the suitable part of tire external surface, sticking, and adhesion on tire external surface is attained after vulcanization by installing the transponder in tire mold before tire vulcanization.

[0028] Moreover, according to the manufacture approach of the transponder of this invention, since mold is not used, it becomes possible to be able to enlarge the degree of freedom of the configuration of a transponder, and also to do the following effectiveness so.

[0029] ** Even if thin, it becomes possible to manufacture a heat-resistant good transponder.

[0030] ** It becomes a flexible transponder and becomes usable according to the configuration of an anchoring object.

[0031] ** Since the thickness (distance to a coating front face) of the coating from a circuit with a built-in transponder can be changed into arbitration on the front reverse side (upper part lower part), it becomes possible to manufacture to arbitration suitably from a thin transponder to a thick transponder.

[0032] ** Since the magnitude of a coating can be changed freely, a transponder can be manufactured cheaply and correspondence becomes possible also at multiproduct production.

[0033] ** Even when a communications antenna (antenna coil) is large, it becomes possible to manufacture the thin transponder excellent in thermal resistance and shock resistance.

[0034] ** It becomes possible to manufacture the transponder excellent in dimensional stability.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The transponder which comes to cover transponder components with silicon resin or cross-linking polyethylene resin.

[Claim 2] The manufacture approach of the transponder which makes it come to harden silicon resin after arranging transponder components on the sheet of silicon resin, covering with the silicon resin this transponder component of whose is not hardened subsequently, arranging another sheet of silicon resin on it and putting transponder components and non-hardened silicon resin with both sheets.

[Claim 3] The manufacture approach of the transponder which makes it come to harden non-hardened cross-linking polyethylene resin after arranging transponder components, arranging another sheet of non-hardened cross-linking polyethylene resin subsequently to a it top and putting transponder components with both sheets on the sheet of non-hardened cross-linking polyethylene resin.

[Translation done.]